

艾布纳 5098 硅凝胶

产品特点

艾布纳 5098 是一款双组份加成型硅凝胶，室温固化，加热可以加速其固化，固化后形成一个非常柔软的弹性体：

- 1:1 质量比混合，使用方便；
- 低粘度，流动性好，易灌封；
- 非常柔软，优异的缓冲能力，对机械部件很好的保护作用；
- 优异的电绝缘性，使用稳定性；
- 优异的耐高低温性能，在-40-200℃的温度下长期使用；
- 无毒无臭无腐蚀性，低油离度；

典型用途

- 汽车和电力电子工业的电子元件的封装；
- 太阳能电池的封装；
- 阻尼元件的生产；
- 洁净室过滤器的密封。

技术参数（不应被视为产品标准使用）

序号	项目		技术指标	检测方法
固化前(23±2℃)				
2	外观	A 组分	透明流体	-
		B 组分	透明流体	
3	粘度（pa.s）	A 组分	1.0	GB/T 2794
		B 组分	1.0	
4	密度（g/cm³）	A 组分	0.97	GB/T 13477
		B 组分	0.97	
5	可操作时间(min)		40-70	-
固化后（常温放置 24h 后）				
6	外观		透明弹性体	-
7	锥入度（1/10mm）		220(100-330 可调整)	GB/T 269

8	体积电阻率（ $\Omega \cdot \text{cm}$ ）	1×10^{15}	GB/T 1692
9	介电常数/60Hz	2.7	GB/T 1693
10	介电强度(kv/mm)	18	GB/T 1695
11	突出特性	柔韧、无黄变、无析油	-

*此数据为标准条件下测定。

使用方法和注意事项

- 按 A: B=1: 1（重量比）均匀混合，灌入需要灌封的基材部位。室温下放置至其形成弹性体，经 24~48 小时后即可使用。
- 使用自动混胶机混胶时，按 A: B=1: 1（重量比）在混胶机上确认后再进行使用。
- 被灌封产品的表面在灌封前必须加以清洁，不得有含 N、P、S、重金属等及其化合物。
- A、B 组分必须充分混合，避免不均匀，影响胶的固化及性能。
- A、B 组分分别储存，现配现用，配制后在短时间内必须用完，避免浪费。

包装、贮存及运输

- 本品采用 2kg、20kg 包装，特殊要求可协商后指定包装。
- 在干燥通风阴凉处贮存，自生产日期起，贮存期为 12 个月。
- 本品按非危险品贮存及运输。

安全须知

本产品属非危险化学品，使用时，对人体和环境无毒害和污染，但在固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请用大量水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免小孩接触。

使用者注意

本文数据是在实验条件下获得，对于任何人采用我们无法控制的方法获得的结果，我们恕不负责。由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进分析和试验。用户在使用过程遇到什么问题，可以和艾布纳公司技术服务部门联系，我们将竭诚为您服务。